

## System Buttering

### Peter Stemmermann

Tłumaczył Kazimierz Dąbrowski

System ten znajduje zastosowanie przy układaniu ceramicznych płytek na cienkich warstwach hydraulicznie twardniejących zapraw, dyspersyjnych i epoksydowych materiałach klejących. Oznacza to naniesienie jednostronne materiału klejącego na spodnią część płytek wykładziny. Cienką warstwę zaprawy lub materiału klejącego nakłada się równomiernie na płytki za pomocą zębatej łopatkki i bezpośrednio przykleja do podłoża, uważając aby przy nakładaniu nie naciskać, lecz raczej wsuwać na podłoże, jak przy systemie Floating (różni się on od systemu Buttering tym, że warstwę klejącą nakłada się na podłoże a nie na płytki). Wielkość stosowanej zębatej łopatkki dobiera się odpowiednio do wielkości płytek .

### Wskazówka praktyczna

W praktyce system Buttering jest rzadko stosowany. Przyczyna tego tkwi w tym, że system ten jest wyraźnie bardziej pracochłonny od systemu Floating. Zastosowanie znajduje system Buttering, gdy płytki układa się w systemie kombinowanym. Jeżeli podłoże nie jest dostatecznie równe, konieczne jest jego wyrównanie odpowiednimi masami.

### Alternatywa

Przy stosowaniu cienkich warstw klejących można płytki także układać w systemie kombinowanym.

### Literatura

DIN 18156. Stoffe f.r keramische Bekleidungen im D.nnbettverfahren, Begriffe und Grundlagen (Materiały do układania ceramicznych wykładzin na cienkich warstwach klejonych, pojęcia i podstawy).

DIN 18 157. Ausf.hrung keramischer Bekleidungen im D.nnbettverfahren, (Wykonanie ceramicznych wykładzin na cienkich warstwach klejowych.

Mit keramischen Fliesen und Platten bauen (Budowa z ceramicznymi płytkami okładzinowymi) Rudolf M.Iler Verlagsgesellschaft.